

薄膜の剥離試験・最表層の分析面出しに

表面・界面 物性解析装置

SAICAS

Surface And Interfacial Cutting Analysis System

ミクロンオーダー(1~500 μ m)対応モデル

EN-W型 (標準仕様)

EN-WA型 (X電動ステージ付)

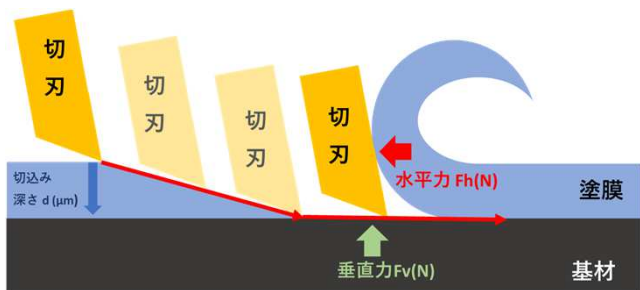
共通基本機能



従来の規格試験では難しい
薄膜・脆性膜・多層膜 の剥離試験が可能

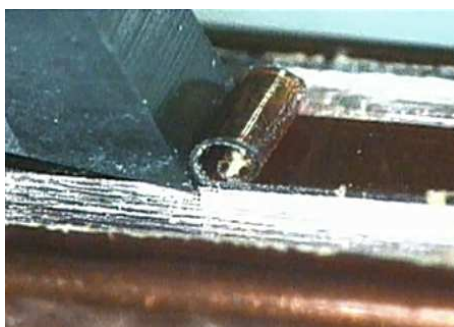
表面分析向けの斜め断面作製が可能

斜め駆動から任意で水平駆動へ切替え 塗膜を切削・剥離

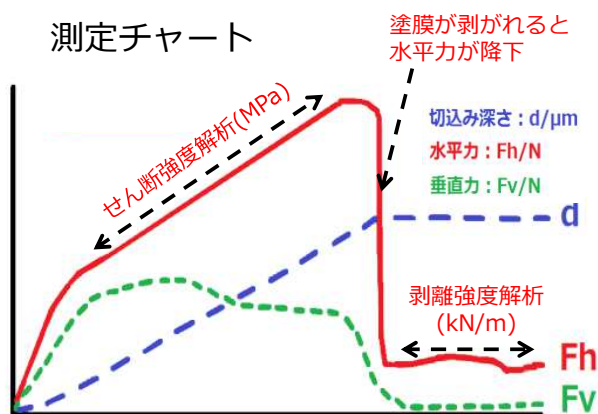


切刃にかかる水平力(N)と垂直力(N)、及び切込み深さ(μ m)を計測

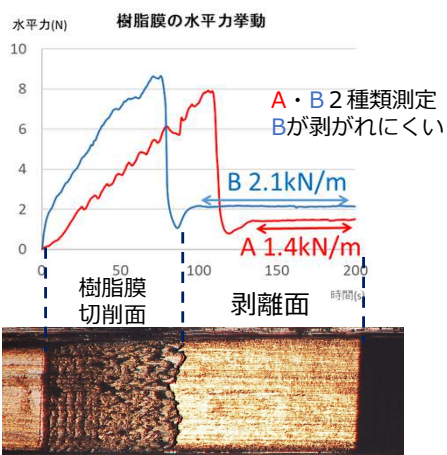
[測定事例] 50 μ m樹脂膜における剥離強度測定



測定チャート



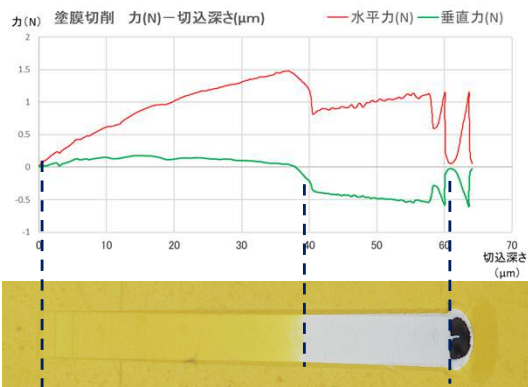
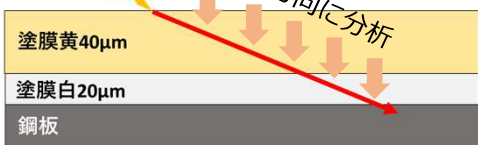
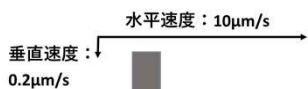
経過時間/sec



[切削加工事例] 積層塗膜(40 μ m/20 μ m)における化学分析前処理の斜め切削

斜め切削した断面を化学分析に活用可能

活用可能化学分析例
TOF-SIMS, FT-IR, ケミルミネッセンスなど



塗膜黄(40 μ m) 塗膜白(20 μ m)
長さ2000 μ m 長さ1000 μ m
分析領域を膜厚の50倍に拡大